



# 平成24年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年12月27日

上場取引所 東

上場会社名 三益半導体工業株式会社  
コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 八高 達郎

四半期報告書提出予定日 平成24年1月13日 配当支払開始予定日

TEL 027-372-2011  
平成24年2月3日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成24年5月期第2四半期の業績(平成23年6月1日～平成23年11月30日)

### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年5月期第2四半期	23,366	△28.7	1,634	12.6	1,504	31.2	855	30.0
23年5月期第2四半期	32,773	38.1	1,451	3.4	1,146	153.6	657	361.2

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年5月期第2四半期	25.54	—
23年5月期第2四半期	19.64	—

### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年5月期第2四半期	70,013	51,927	74.2
23年5月期	74,609	51,485	69.0

(参考) 自己資本 24年5月期第2四半期 51,927百万円 23年5月期 51,485百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
24年5月期	—	12.00	—	—	—
24年5月期(予想)	—	—	—	12.00	24.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成24年5月期の業績予想(平成23年6月1日～平成24年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	50,000	△16.0	2,500	1.4	2,200	8.5	1,200	17.8	35.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年5月期2Q	35,497,183 株	23年5月期	35,497,183 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

24年5月期2Q	2,014,838 株	23年5月期	2,014,746 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年5月期2Q	33,482,407 株	23年5月期2Q	33,483,076 株
----------	--------------	----------	--------------

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】3ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. 四半期財務諸表 .....	4
(1) 四半期貸借対照表 .....	4
(2) 四半期損益計算書 .....	5
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....	6
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	7
(5) セグメント情報 .....	7
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	7

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、生産に持ち直しの動きが見られたものの、円高の進行や世界的な景気減速などの影響により予断を許さない状況が続きました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、東日本大震災後、サプライチェーンの復旧とともに生産に回復の動きが見られましたが、その後、半導体デバイス需要の悪化から一部で調整局面に入るなど、後半は厳しい事業環境となりました。

このような経営環境の中で当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、省電力対策の実施など、総力を挙げて粘り強く業績の改善に取り組みました。

当第2四半期累計期間の業績は、産商事業部の売上高が減少したことにより233億6千6百万円と前年同四半期比28.7%の減収となったものの、営業利益は16億3千4百万円(前年同四半期比12.6%増)、経常利益は15億4百万円(同31.2%増)、四半期純利益は8億5千5百万円(同30.0%増)と増益になりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、主力の300mmウエハの生産は概ね底堅く推移いたしましたが、後半の生産には総じて減速感が見られました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、厳しい経済環境を反映してその他の取扱商品において大幅な減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化しつつ、産商事業部を通じた自社開発製品の販売活動を積極的に展開いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

## (2) 財政状態に関する定性的情報

## ①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して45億9千5百万円減少し、700億1千3百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により50億3千7百万円減少し、180億8千6百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加4億5千3百万円等により、519億2千7百万円となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は177億2百万円となり、前事業年度末に比べ23億4千9百万円の減少となりました。営業活動の結果使用した資金は5億9千3百万円となりました。これは税引前四半期純利益14億7千6百万円、減価償却費22億3千7百万円等による資金の増加があったものの、仕入債務の減少29億7千6百万円、法人税等の支払10億3千万円等があったことによるものです。投資活動の結果使用した資金は13億4百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出12億6千9百万円によるものです。財務活動の結果使用した資金は4億5千1百万円となりました。これは配当金の支払4億1百万円等があったことによるものです。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成24年5月期の業績予想につきましては、平成23年9月29日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年11月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	20,051	17,702
受取手形及び売掛金	18,620	17,456
商品及び製品	154	202
仕掛品	374	583
原材料及び貯蔵品	911	913
その他	1,003	1,730
貸倒引当金	△20	△17
流動資産合計	41,096	38,571
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	15,453	14,748
その他(純額)	14,113	13,061
有形固定資産合計	29,567	27,810
無形固定資産		
投資その他の資産	1,625	1,452
固定資産合計	2,320	2,179
固定資産合計	33,512	31,442
資産合計	74,609	70,013
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,550	13,114
短期借入金	100	100
未払法人税等	1,087	504
引当金	95	37
その他	3,369	2,438
流動負債合計	21,201	16,195
固定負債		
長期借入金	350	300
退職給付引当金	1,383	1,403
その他	188	187
固定負債合計	1,922	1,890
負債合計	23,123	18,086
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	17,314	17,767
自己株式	△3,409	△3,409
株主資本合計	51,507	51,960
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△21	△33
評価・換算差額等合計	△21	△33
純資産合計	51,485	51,927
負債純資産合計	74,609	70,013

(2) 四半期損益計算書  
第2四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年11月30日)
売上高	32,773	23,366
売上原価	30,038	20,456
売上総利益	2,735	2,909
販売費及び一般管理費	1,283	1,275
営業利益	1,451	1,634
営業外収益		
受取利息	2	3
受取配当金	1	2
その他	50	11
営業外収益合計	54	17
営業外費用		
支払利息	0	1
為替差損	43	27
設備休止費用	279	84
その他	36	34
営業外費用合計	359	147
経常利益	1,146	1,504
特別利益		
固定資産売却益	2	0
貸倒引当金戻入額	20	—
特別利益合計	23	0
特別損失		
固定資産売却損	30	0
固定資産除却損	11	24
減損損失	3	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	9	—
災害による損失	—	2
特別損失合計	55	27
税引前四半期純利益	1,114	1,476
法人税、住民税及び事業税	481	454
法人税等調整額	△24	167
法人税等合計	456	621
四半期純利益	657	855

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期累計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年11月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益	1,114	1,476
減価償却費	2,642	2,237
減損損失	3	—
受取利息及び受取配当金	△3	△5
支払利息	0	1
為替差損益(△は益)	0	0
売上債権の増減額(△は増加)	△1,583	1,164
たな卸資産の増減額(△は増加)	55	△258
仕入債務の増減額(△は減少)	△223	△2,976
その他	169	△1,201
小計	2,174	439
利息及び配当金の受取額	4	4
利息の支払額	△0	△1
法人税等の支払額	△159	△1,030
法人税等の還付額	450	—
災害損失の支払額	—	△5
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,469	△593
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△2,586	△1,269
有形固定資産の売却による収入	3	0
無形固定資産の取得による支出	△52	△24
その他	△14	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,649	△1,304
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	500	—
長期借入金の返済による支出	△50	△50
配当金の支払額	△401	△401
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	48	△451
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△131	△2,349
現金及び現金同等物の期首残高	14,521	20,051
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,390	17,702



## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報

報告セグメントごとの売上高に関する情報  
前第2四半期累計期間(自平成22年6月1日至平成22年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	15,087	17,524	161	32,773	—	32,773
セグメント間の内部売上高 又は振替高	4	—	834	839	△839	—
合計	15,091	17,524	996	33,612	△839	32,773

当第2四半期累計期間(自平成23年6月1日至平成23年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	13,881	9,484	—	23,366	—	23,366
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3	—	542	546	△546	—
合計	13,884	9,484	542	23,912	△546	23,366

## (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。